

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-11

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 现场参观 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 其他（ <u>券商策略会</u> ）
活动参与人员（排名不分先后）	中银证券、国金证券、华源证券、泰康资产、易方达基金、富国基金、汇添富基金、财通基金、中银基金、中欧基金、华安基金、平安养老、中信资管、湘财基金、财通资管、浦银安盛基金、建信基金、长城基金、申万菱信、招商基金、民生通惠
上市公司接待人员	副总经理、董事会秘书：张丽君；战略发展部总监、证券事务代表：谢丹；投资者关系经理：郭家旭
时间	2025 年 3 月 21 日
地点	机构投资者所在地（上海）、华源证券策略会举办地
形式	实地调研
投资者关系 活动主要内容介绍	交流主要内容： Q1、请介绍 2024 年公司 PCB 业务营业收入及毛利率的变动原因。 2024 年，PCB 业务实现主营业务收入 104.94 亿元，同比增长 29.99%；毛利率 31.62%，同比增加 5.07 个百分点。PCB 业务充分把握算力以及汽车电子市场的机遇，实现营收和利润的稳健增长。PCB 业务营收层面的增长贡献主要集中在集中在通信领域 400G 及以上的高速交换机、光模块产品需求增长；数据中心领域 AI 服务器及相关配套产品需求增长，以及服务器总体需求显著回温；汽车电子领域电动化/智能化趋势促进订单需求持续释放。 PCB 业务毛利率的增长得益于营收规模增加，PCB 工厂产能利用率提升，AI 相关领域订单需求增长助益 PCB 业务产品结构优化。同时，公司针对性开展多项运营管理能力提升工作，通过提升原材料利用率、前置引导客户设计、优化能源管理等多种方式强化成本竞争力，并针对部分瓶颈工序进行技术提效，保障高效产出，对 PCB 业务毛利率的提升起到正向作用。

Q2、请介绍 2024 年公司封装基板业务营业收入及毛利率的变动原因。

2024 年,封装基板业务实现主营业务收入 31.71 亿元,同比增长 37.49%;毛利率 18.15%,同比减少 5.72 个百分点。封装基板业务在全球基板行业温和修复的环境下,加大市场拓展力度,加快推进新产品和新客户导入,推动订单较去年增长。封装基板业务毛利率的下降主要由于广州封装基板项目爬坡、金盐等部分原材料涨价,叠加下半年 BT 类基板市场需求波动、基板工厂产能利用率有所下降等因素共同影响。

Q3、请介绍公司封装基板业务在 FC-BGA 产品方面取得的进展。

公司 FC-BGA 封装基板已具备 16 层及以下产品批量生产能力,18、20 层产品具备样品制造能力,各阶产品相关送样认证工作有序推进,20 层产品目前在客户端认证环节已取得比较良好的结果。

Q4、请介绍公司广州封装基板项目连线爬坡进展。

公司广州封装基板项目一期已于 2023 年第四季度连线,产品线能力持续提升,产能爬坡稳步推进,已承接包括 BT 类及部分 FC-BGA 产品的批量订单,但总体尚处于产能爬坡早期阶段,重点仍聚焦能力建设,由此带来的成本及费用增加,对公司利润造成一定负向影响。

Q5、请介绍公司 PCB 业务主要产品下游应用分布情况。

公司在 PCB 业务方面从事高中端 PCB 产品的设计、研发及制造等相关工作,产品下游应用以通信设备为核心(覆盖无线侧及有线侧通信),重点布局数据中心(含服务器)、汽车电子(聚焦新能源和 ADAS 方向)等领域,并长期深耕工控、医疗等领域。其中,数据中心领域在 2024 年度成为公司 PCB 业务继通信领域之后,第二个达 20 亿元级订单规模的下游市场。

Q6、请介绍公司 PCB 业务在汽车电子领域产品布局情况。

汽车电子是公司 PCB 业务重点拓展领域之一,主要面向海外及国内 Tier1 客户。公司以新能源和 ADAS 为主要聚焦方向,主要生产高频、HDI、刚挠、厚铜等产品,其中 ADAS 领域产品主要应用于摄像头、雷达等设备,新能源领域产品主要集中于三电系统(电池、电控、电机)层面。

	Q7、请介绍公司 PCB 业务在 PTFE 方面的布局情况。 PTFE 材料在高频 PCB 领域已有比较成熟的应用，公司在通信、汽车 ADAS 等高频应用场景已有相关成熟 PCB 产品。行业对 PTFE 在高速 PCB 领域的开发和大批量应用尚处在早期阶段，公司对行业前沿技术及应用保持关注与研究，已具有相应技术储备。 Q8、请介绍公司近期产能利用率情况。 公司 PCB 业务因目前算力及汽车电子市场需求延续，近期工厂产能利用率仍保持在高位运行；封装基板业务受近期存储领域需求相对改善，工厂产能利用率环比第四季度略有提升。 Q9、请介绍公司 PCB 业务近年来扩产规划。 公司 PCB 业务在深圳、无锡、南通及泰国项目（在建）均设有工厂。一方面，公司可通过对现有成熟 PCB 工厂进行持续的技术改造和升级，增进生产效率，释放一定产能；另一方面，公司南通四期项目已有序推进基建工程，拟建设为具备覆盖 HDI 等能力的 PCB 工艺技术平台。公司将结合自身经营规划与市场需求情况，合理配置业务产能。 Q10、请介绍公司泰国工厂投资规模及建设进展。 公司在泰国工厂总投资额为 12.74 亿元人民币/等值外币。目前基础工程建设有序推进中，具体投产时间将根据后续建设进度、市场情况等因素确定。泰国工厂的建设有利于公司进一步开拓海外市场，满足国际客户需求，完善产品在全球市场的供应能力。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单	无